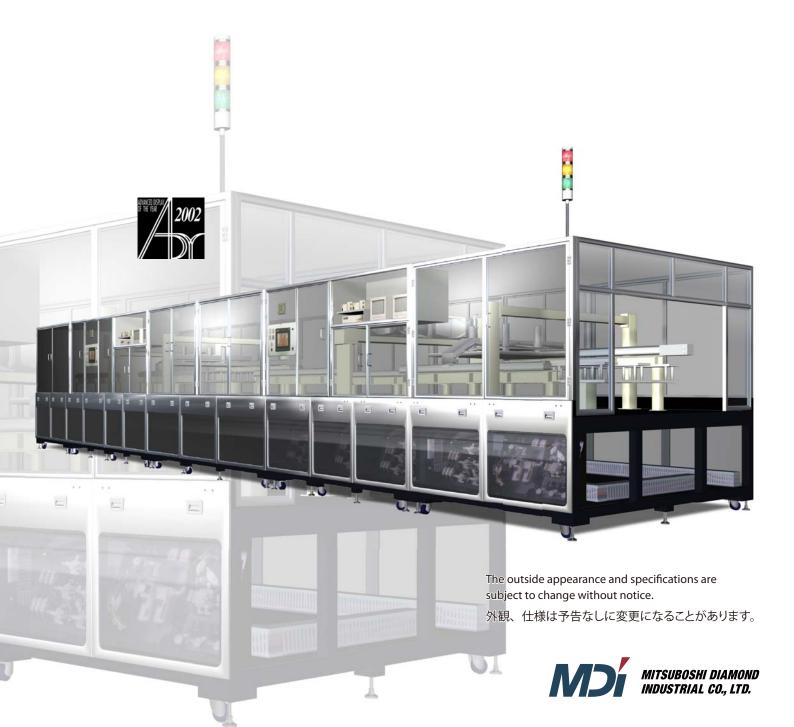
MPL Series

High precision flipless cutting system.

高精度上下分断ラインシステム。

Scribing large-scale TFT substrates above and below simultaneously, this system is ideal for increasingly large substrates.

大型 TFT 基板を上下から同時にスクライブすることで、基板の大型化に対応。



In-line Flipless Cutting System

上下分断ライン MPL シリーズ

MPL Series

MPL Secifications

Glass Thickness	対応基板厚み	Single Substrate / 単板	0.4mm-1.1mm
		Assembled Panel /貼り合せ基板	0.8mm-2.2mm
Substrate Size	対応基板サイズ		G8 2,200×2,500mm MAX
Scribe Velocity	スクライブ速度		600mm/sec MAX
Scribe Accuracy	スクライブ精度	Straight Scribe /直線	±40μm
Operating System	動作制御		PCWindows®OS
Alignment System	画像認識	2 cameras with auto alignment by gray image processing	
Dimensions(W×D×H)	装置寸法	Depend on customer specifications	お客様の仕様により異なります
Weight	重量	Depend on customer specifications	お客様の仕様により異なります

Applications

FPD, LCD, Optical Component, Solar Cells, Glass Cover (TV, Moniter) and other brittle materials.

- CE marking accreditation is optionally available.
- Contact www.mitsuboshidiamond.com

